

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-018

鸿日达科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损为 -151,375,788.09 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定，结合公司 2025 年的经营状况及未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，提升经营业绩。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿日达	股票代码	301285
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	蔡飞鸣		
办公地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号		
传真	0512-57379860		
电话	0512-57379860		
电子信箱	hrdzq@hrdconn.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

公司系专业从事精密连接器及机构件的研发、生产及销售的高新技术企业。成立至今，始终坚持以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理念，致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品，形成了以连接器为主、以机构件为辅的产品体系，广泛应用于手机、智能穿戴设备、电脑等消费电子领域。依靠过硬的品质和优质的服务，公司与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴通讯等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。为进一步提升核心竞争力，公司管理层根据行业发展趋势，利用现有的市场地位与客户资源，以自主创新、产品开发为核心，以模具、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序制造技术为支撑，同时向工业连接器、新能源连接器等细分领域进行布局和拓展。

公司一直高度重视对研发能力的投入，不断增加对高端人才的引进和培养，加强与国内外顶尖院校的合作，努力根据技术发展和市场需求开发新技术、新工艺、新产品。自上市以来，持续对应用于半导体芯片封装层级的散热材料进行研发投入并达至量产能力。本报告期内，公司全力聚焦于该产品的国内外客户验证导入工作，已正式取得了多家行业重点客户的供应商代码（Vendor Code），并已开始批量供货。

在 3D 打印方面，经过持续的研发投入，公司现已具备 3D 打印设备的制造能力，进入设备批量生产阶段。目前公司具备了从打印设备开发到产品打印再到后端加工（包括热处理、CNC、研磨、抛光、PVT 喷涂等）的全制程自研工艺的量产能力，可以为客户提供从坯料到成品的一站式服务。公司的 3D 打印技术除用于制造消费电子产品的零部件之外，还在液冷板、微通道散热等方面进行工艺探索与产品开发，并逐步向客户进行送样验证。

报告期内，公司扩大了经营范围，新增加光缆、光纤、光通信设备及光电子器件的制造与销售等业务。基于长期以来对光通信行业的关注，凭借多年累积的自动化研发能力，公司在 FA（光纤阵列）的特定制造环节成功研发出自动化生产设备，提升了产品的生产效率和良率，全力打造针对不同产品的自动化产线。目前光通信器件产品已陆续获得部分客户的供应商资质。

借助中国完善的供应链体系，经过近年来的筹备与产线布局，公司于报告期内逐步在海外形成一定的光伏组件制造能力，依托本地化生产优势，快速响应客户需求，逐步实现批量出货。

2025 年公司在消费电子行业周期性复苏的带动下，持续拓展国内业务、积极布局海外市场，在新产品开发和客户导入等方面都实现了重大突破，精密机构件、散热片、光通信器件等产品均取得了较为明显的阶段性成长。本报告期内公司营业收入整体保持稳定增长，但由于持续加大在 3D 打印、散热片、光通信器件等新领域产品的商业化应用投入，管理费用和销售费用同比增长较快，叠加原材料采购价格持续上涨，导致公司的盈利水平承压，净利润出现亏损。

2、公司主要产品介绍

(1) 消费电子连接器

公司消费电子连接器产品主要为卡类连接器、I/O 连接器、耳机连接器、电池连接器及板对板（BTB）连接器等，广

泛应用于多种类型的手机、耳机、数据线、电脑及其他消费电子产品。

公司连接器主要产品如下：

类别		功能及产品应用领域	示意图
大类	细分类别		
卡类连接器	卡座连接器	卡类连接器主要用于连接 SIM 卡或记忆卡与机内相关电路进行通讯，应用于手机等通讯终端产品。	
	卡托连接器		
I/O 连接器	Type-C 连接器	主要用于充电、数据传输等，广泛应用于手机等智能终端、耳机、数据线等手机周边产品以及无线耳机等消费电子产品。	
	USB 连接器	主要用于充电、数据传输等，应用于智能终端、移动电源等。	
	HDMI 连接器	主要用于专用型数字化影像传输，应用于 PC、机顶盒、投影机及高清电视等设备。	
耳机连接器		耳机连接器主要用于连接耳机与机内相关电路进行音频信号传输，应用于手机及周边产品、电脑等通讯终端产品。	
电池连接器		电池连接器主要用于 3C 电子产品中锂电池的电力传输。	
其他	ZIF 连接器	即 Zero Insertion Force 连接器，用于电子产品内部不同柔性 PCB 板的连接。	
	弹片连接器	借助于金属弹片的导通性，起到一个优质开关的作用，应用于手机、电脑等通讯终端产品。	

	BTB 连接器	BTB 连接器用于连接 PCB/FPCB，应用于手机、电脑等终端产品。	
--	---------	-------------------------------------	---

卡类连接器主要用于手机等通讯终端产品内部电路与 SIM 卡或记忆卡的连接，因客户需求不同，卡类连接器形态、结构亦呈现多样化。公司的卡类连接器产品主要包括卡座连接器及卡托连接器。卡座连接器包括单卡（单 SIM 卡/单 T-Flash 卡）卡座、多合一（一体式/分体式）卡座等；卡托多为配合卡座使用，用于放置 SIM 卡、T-Flash 卡，包括单卡、多合一卡托，按材质分有塑胶卡托、金属埋入成型卡托及 MIM 卡托。

I/O 连接器用于实现外界与设备或不同设备之间的数据传输及交换。公司的 I/O 连接器主要包括 Type-C、Micro USB、HDMI 等系列。

耳机连接器主要用于实现耳机与机内相关电路进行音频信号传输。公司目前的耳机连接器产品包括普通耳机座、防水耳机座、耳机座转接头等产品系列。

板对板（BTB）连接器主要用于 PCB/FPCB 电路板相关连接，广泛应用于显示模组、指纹模组、摄像模组、声学模组、电池模组等专业模组与主板之间的连接，具有信号传输能力强、高频传输稳定、降噪、轻薄及无需焊接等优点。在手机轻薄化的趋势下，板对板（BTB）连接器能够通过实现超低高度和超窄间距以达到减薄机身和减少占板面积的目的。手机中应用板对板（BTB）连接器的数量随着功能模块的增多而增多。

(2) 精密机构件

公司的精密机构件产品主要通过金属粉末注射成型（MIM）及 3D 打印等不同工艺进行生产。相关的工艺在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势。公司目前已掌握了 MIM 工艺的核心技术，生产的产品包括摄像圈支架、摄像头装饰件、笔记本转轴、智能手表卡扣等，主要应用于手机、电脑等便携式智能终端，以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。同时，公司已成功研制出 3D 打印设备，可为客户提供从产品打印及后端加工（包括热处理、CNC、研磨、抛光、PVT 喷涂等）的全流程一站式服务。



摄像头装饰件



摄像圈支架



笔记本转轴



智能手表卡扣

应用领域



(3) 半导体封装级金属散热片

半导体封装级金属散热片是一种应用在半导体芯片封装层级的散热组件。其贴附在晶圆表面、实现导热和散热，从而帮助控制半导体器件（如 CPU 处理器、GPU、FPGA、ASCI 等芯片）的温度，确保其在正常工作范围内运行。

随着半导体技术的不断进步和集成度的持续提高，现代化电子产品也逐步向高性能、高频高速、以及轻薄化方向演进。半导体制程技术的不断微缩导致芯片封装的空间被压缩得更加窄小，单位体积需要散发的热量不断提升，电子元器件

件的发热密度越来越高。尤其是在 AI 大时代下，各类芯片需在更长的工作时间内处理更多数据信息以提升计算效能，若其产生的热能无法快速散出，累积叠加后的热量将对芯片的安全产生极大威胁。因此，金属散热片在维持半导体元器件的稳定运行、防止热失效以及提升性能等方面的作用日益凸显，已逐步成为半导体热管理解决方案中的核心组件。

另一方面，随着 5G、物联网、人工智能、AI 算力、智能驾驶、通信（服务器、基站等）、存储等领域的前沿技术快速发展，金属散热片的市场前景更加广阔。这些前沿创新对硬件设备的性能要求更高，尤其是在高性能计算、数据中心等领域，对高效热管理解决方案的需求更加迫切。这些领域不仅对散热材料的性能有更高要求，还对其可靠性和效率制定了更为严格的标准。半导体芯片封装层级的散热材料开始向以金属散热片为主的升级，尤其在面向 AI 领域的 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等芯片已成为标配，并随着芯片制程和效率升级朝着大尺寸、高附加值的方向发展。部分采用传统塑封散热的芯片（比如高性能存储芯片）也有向金属散热片升级的趋势。

3、公司主要经营模式

（1）研发模式

以技术为驱动，以市场需求为导向，公司不断进行自主研发，形成了主动研发和按客户需求研发双同步的研发模式。主动研发模式为基于对连接器行业发展趋势、前沿技术的分析判断，结合对客户、市场需求变化的理解，布局新的研究方向或者对原有技术进行升级，不断提升工艺水平。按客户需求研发模式是以客户需求为核心，根据客户对功能特点、技术参数、应用场景等方面的不同需求，进行定制化的研发。

公司主动研发和按客户需求研发共同实施的研发模式，兼顾技术储备和定制化诉求，在提升自身技术实力的过程中满足了客户多样化需求。

（2）采购模式

公司生产经营所需的原材料及其他物资由资材部负责，对采购的全过程进行控制与管理。公司制定了合格供应商名册，每年均进行考核并动态更新。公司一般从原材料价格、产品品质、供货保证、交付时效及售后服务等方面对供应商进行综合评估，遵循《供应商管理程序》进行选择，并经送样至品保部确认后，方可列入公司合格供应商名册。公司在确定合格供应商名册后与之签订长期采购的框架合同，对产品质量、采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定。公司采购的原材料价格由供应商先行报价，公司与供应商进行比价、议价后，将最终确定的价格录入 ERP 系统。经过多年发展，公司已建立了完善的供应商选择及管理体系，可有效保障公司各类物资材料的供应。

公司对生产所需物料主要采用“以产定购”的采购模式，即根据生产需求安排订单物料采购。公司生产计划下达后，由生产管理人员做出物料需求表，资材部比较 ERP 系统中的供应商产品价格后，最终选定供应商并向其发出采购单。供应商交货后，经品保部检验质量合格，由仓库接收物料并清点交货数量后办理入库。

（3）生产模式

公司产品种类及规格繁多，不同客户、不同产品对连接器的性能、规格要求各不相同，且对产品的交货周期有严格要求，因此公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户的订单统筹安排生产，满足客户的定制化需求。业务部接到客户订单后，录入 ERP 系统，将需求转化成系统中的销售订单。生产管理人员接收到来自业务部的销售订单后，先核查成品库存状况，若成品足够，则回复业务部交期；若成品不足，则由生产管理人员发出生产排配单通知备料生产。在所需物料不足的情况下，生产管理人员提出物料需求表，由权责主管核准后转呈资材部进行物料采购。生产部严格按照生产计划及生产排配单安排领料生产。生产管理人员每日产销例会追踪生产进度，确保生产按计划进行。品保部对来料、半成品、首件及成品进行全流程检验，确保产品品质满足客户需求。在整个生产过程中，业务部、生产部、资材部、品保部等部门良好的跨部门协作，确保了品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达成。

（4）销售模式

公司对于产品销售采用直销模式，由业务部具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。经过多年发展，公司凭借一流的技术、可靠的产品和完善的服务，在业内积累了较高的品牌知名度，和众多优质客户建立了长期合作关系。报告期内，合作客户的订单增长是公司销售持续增长的主要来源。公司销售团队通过参加展会、拜访潜在客户、现有客户介绍等多种方式积极开拓新客户。

根据行业特点，新客户在与公司确认合作关系前，一般须通过客户的认证，纳入合格供应商体系后，客户方才正式下达订单进行采购。公司按照客户的订单需求组织安排生产。产品完工后，根据订单具体约定，公司主要采用第三方物流运输的方式将产品发送至客户指定地点。客户确认收货后根据约定的支付条件向公司支付货款，最终完成产品的销售过程。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	1,971,479,428.89	2,009,782,688.44	-1.91%	1,868,114,517.85
归属于上市公司股东的净资产	961,835,088.31	1,025,400,303.65	-6.20%	1,068,630,545.45
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	1,018,961,001.32	830,331,289.65	22.72%	720,674,938.04
归属于上市公司股东的净利润	-67,226,702.26	-7,572,834.80	-787.73%	30,998,055.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,141,794.86	-9,005,160.42	-756.64%	17,040,981.71
经营活动产生的现金流量净额	40,978,054.56	38,163,096.58	7.38%	87,072,574.09
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.04	-725.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-0.04	-725.00%	0.15
加权平均净资产收益率	-6.81%	-0.73%	-6.08%	2.92%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,248,905.57	275,596,925.57	255,467,419.86	325,647,750.32
归属于上市公司股东的净利润	-12,170,909.33	5,029,209.34	-11,558,551.09	-48,526,451.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,475,472.46	6,335,058.39	-12,371,029.08	-52,630,351.71
经营活动产生的现金流量净额	49,873,643.70	-151,704,813.45	108,307,417.59	34,501,806.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,344	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王玉田	境外自然人	44.90%	92,799,243.00	92,799,243.00	质押	12,700,000.00			
昆山豪讯宇企业管理有限公司	境内非国有法人	10.48%	21,660,949.00	21,660,949.00	不适用	0.00			
石章琴	境外自然人	3.67%	7,580,000.00	7,500,000.00	不适用	0.00			
东台昌旭企业管理有限公司	境内非国有法人	2.90%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00			
国信证券股份有限公司	国有法人	1.49%	3,074,831.00	0.00	不适用	0.00			
沈剑峰	境外自然人	1.33%	2,751,000.00	0.00	不适用	0.00			
宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司一佳然一号私募证券投资基金	其他	0.63%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00			
龚良昀	境内自然人	0.60%	1,248,100.00	0.00	不适用	0.00			
周海霞	境内自然人	0.60%	1,230,000.00	0.00	不适用	0.00			
廖满妹	境内自然人	0.48%	990,300.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王玉田、石章琴为夫妻关系，王玉田直接持有公司 44.90% 的股份，石章琴直接持有公司 3.67% 的股份。王玉田持有公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司 44.72% 的股权、同时任其执行董事。王玉田系公司股东东台昌旭企业管理有限公司的唯一股东，同时任其执行董事。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

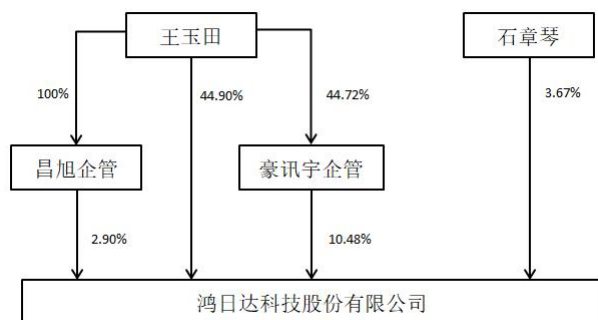
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

详见公司 2025 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。